

< 정상추진 >

18. 시스템반도체 첨단 후공정 기술지원 인프라 구축

주관부서	산업육성과	과장	이용일(☎8450)	반도체산업팀장	이재명(☎8461)
				담당자	김웅(☎8462)
신규 / 지속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	국가	

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2031.(10년)
- 총사업비 : 1,787억원(국비 703, 도비 542, 시군비 542)
- 사업내용 : 시스템반도체 첨단 후공정 기술지원 인프라 구축
 - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화('21.~'23., 87억원)
 - 시스템반도체 첨단AI 분석플랫폼 구축('22.~'24., 91.5억원)
 - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축('23.~'25., 200억원)
 - 지능형반도체·IT 소부장 지원센터 구축('23.~'26., 214억원)
 - 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼 구축 추진('25.~'31., 1,500억원)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	1,787	25	32	63	114	353	628	572	446	25	32	173	216	-	-	-
국 비	703	17	22	41	22	73	242	286	165	17	22	85	41	-	-	-
도 비	542	4	5	11	46	140	193	143	137	4	5	51	77	-	-	-
시군비	542	4	5	11	46	140	193	143	132	4	5	31	92	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	6	6	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업 추진 : 7. ~ 12.
 - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 사업 기획 : 7. ~ 12.

○ 추진실적

- 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업추진 : 7. ~ 12. / 2차년
 - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 신규과제 선정(산업부) : 5.
 - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축 과제 컨설팅 : 7.~12. / 4회
 - 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축* 정부예산(78억원) 확정 : 12.
- * 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업으로 명칭 변경

【 2023년 】

○ 추진계획

- 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 3차년도 사업추진 : 1.~12.
- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 협약 및 추진 : 1.~12.

○ 추진실적

- 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 3차년도 장비 발주 : 1. ~ 3.
 - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 발표평가 등 대응 : 2. ~ 3.
 - 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업* 최종 공모선정 : 4. 12.
 - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 최종 공모선정 : 4. 13.
- * 첨단 반도체 후공정 기술지원을 위한 추가 신규사업 공모 선정('23.~'26., 214억원)
- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 1차년도 사업비 교부 : 6. 21.
 - 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 1차년도 사업비 교부 : 9. 25.
 - 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 장비발주 및 건축설계 추진 : 9.~12.
 - 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 장비발주 및 건축설계 추진 : 9.~12.
 - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화사업 사업완료 : ~ 12.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 2차년도 사업추진 : 1.~12.
- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 2차년도 사업추진 : 1.~12.

○ 추진실적

- 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 건축시공*, 장비구축** 추진 : 1. ~ 3.
- *건축시공(1,110㎡) 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 감리, 폐기물 조달공고 진행
- **이온단면가공기(2.03억), 원자힘현미경(3.85억), 적외선분광기(1.74억) 등

- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 사업계획 변경* 및 협약 : 1. ~ 3.
*24년 국비 감액 : 2,309백만원 → 1,095백만원(1,214백만원 감, 약 52.6%감)에 따라 연차별 장비구축 계획 변경
- 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 건축공사 착공, 시공 중 : 5. ~ 10.
- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 건축설계* 완료, 조달계약 : 8. ~ 9.
*센터(2,000㎡/2층) 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 감리, 폐기물 조달공고 진행/ 장비2종 구매완료

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충북 반도체산업 육성 전략 발표(10.26. 충북넷 등 다수)

【 2023년 】

- 2023년 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 공고(3.2.)
- 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 공모선정(4.14., 충청타임즈 등 다수)
- 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 공모선정(4.17., 충청타임즈 등 다수)
- 충북 반도체산업 육성전략 2.0 발표(10.10.)
 - 4대분야 12대 중장기프로젝트 추진 / 23개 언론사, 8개 방송사 보도

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 2022 반도체전문가포럼 개최(10.26., 그랜드플라자 청주호텔)
 - 충북반도체산업육성협의회 및 산학연 관계자 80여명 참여

【 2023년 】

- 2023 반도체전문가포럼 개최(2.17., 그랜드플라자 청주호텔)
 - 충북반도체산업육성협의회 및 산학연 관계자 80여명 참여

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 정부(산업부)의 첨단 패키징 인프라 예타사업 추진 불가 방침
- (대책) 사업 타당성 강화 및 비예타 규모 신규사업 단계적 추진
 - 충북 반도체특화단지 지정 등 패키징 인프라 구축 타당성 강화 및 정부 설득을 통한 사업 추진 방안 모색
 - 비예타 규모의 첨단 후공정 기술지원 신규사업 단계적 추진

□ 향후계획

- 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축사업 연차별 사업추진('23. ~ '25.)
- 지능형반도체IT 소부장 지원센터 구축사업 연차별 사업추진('23. ~ '26.)
- 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼 구축사업 등 단계별 지원사업 발굴 추진('25. ~ '31.)

□ 기대효과

- 차세대 반도체 성능향상에 핵심 분야인 첨단 후공정 인프라 구축 및 기술 지원을 통한 반도체기업 기술경쟁력 강화 및 후공정 산업 선점

- ▶ 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원사업 공모선정('23.4)
- '23~'25. / 199.9억원
- ▶ 지능형반도체·IT 소부장 지원센터 구축사업 공모선정('23.4)
- '23~'26. / 214억원
- ▶ 충북 반도체산업 육성전략 2.0 발표 및 대내외 홍보('23.10)
- ▶ 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 사업 완료('23.12)
- '21~'23. / 87억원